



全面啟動情境感知邊緣裝置 AI 視覺應用 奇景光電推出 Intelli-Sensing 智慧感測模組解決方案

【台南，2022年3月28日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（28）日宣布，推出超低功耗 Intelli-Sensing 智慧感測模組解決方案，針對邊緣裝置應用提供多種 AI 視覺情境感知功能，如人形偵測、人流計數、人臉偵測及人臉辨識等。奇景 Intelli-Sensing 智慧感測模組將於 2022 年 3 月 29 日至 30 日舉行的 tinyML 高峰會（tinyML Summit 2022）上首次對外發表。

Intelli-Sensing 智慧感測模組內含奇景獨家 WE-I Plus AI 處理器和 HM01B0 全時（Always-On）影像感測器，兩者均具備超低功耗特性。奇景高整合度 Intelli-Sensing 智慧感測模組擁有迷你的體積，僅 12.5 釐米長、17 釐米寬和 2.45 釐米高，模組提供 22-pin FPC 連接器腳位輸出，可透過通用型 24-pin ZIF FPC 連接器、或以標準表面黏著技術方便地與系統主功能板連接，大幅簡化系統整合工作。針對視覺感測應用，奇景 Intelli-Sensing 智慧感測模組，提供多種可程式化燒錄之預訓練機器學習軟體模型（pre-trained machine learning models），如人形偵測、人流計數、人臉偵測及人臉辨識等。面對不同應用情境，可選擇對應的應用推論（inference）軟體模型燒錄至模組，在邊緣裝置系統中執行運算，運算後再將僅數個位元大小的辨識結果（metadata），傳送到雲端設備進行終端處理，避免進行量大的原始影像資料傳送，藉此可保有隱私並大幅降低資料傳輸延遲及功耗，進而提升使用者體驗。

奇景光電智慧感測事業部副總經理陳有棟表示，Intelli-Sensing 智慧感測模組已進入量產階段，內含奇景超低功耗 WE-I Plus AI 處理器、HM01B0 QVGA 解析度影像感測器和系統整合所需的軟體堆疊（software stack）及預訓練機器學習模型的完整解決方案，可以協助新進入業者和系統開發者，完美地降低在邊緣裝置系統中，開發電腦視覺或機器學習所面臨的高設計門檻，減少開發者在軟體、硬體及影像感測模組整合設計及開發心力，並簡化料件採購及模組生產流程。應對更多客戶於視覺 AI 的新型應用需求，奇景 Intelli-Sensing 智慧感測模組，將持續推出更多樣化的 AI 視覺感測軟體方案，來加值客戶邊緣裝置設備。

奇景 Intelli-Sensing 智慧感測模組主要針對人機介面裝置、智慧家庭及智慧零售等應用，提供完整解決方案，奇景光電將於 3 月 29 日至 30 日舉行的 2022 tinyML 高峰會（tinyML Summit 2022）上發表並展示相關場景應用。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動 IC 與時序控制 IC 領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制 IC、手持式與

擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥 (LCoS) 微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED 驅動 IC、電源管理 IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D 感測及機器視覺的 CMOS 影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材、家電及物聯網等。奇景光電設立於 2001 年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為 2,100 人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本、以色列與美國。至 2022 年 2 月 28 日為止，奇景光電在全球已取得 3,032 項專利，尚有 462 項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang

公共關係 資深專案經理

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

+886-3-516-3276

jessica_huang@himax.com.tw

刁玉苹 / Karen Tiao

投資人關係 專案經理

奇景光電股份有限公司

Himax Technologies, Inc.

+886-2-2370-3999

hx_ir@himax.com.tw

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2021 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。